

Поскольку L связано с τ соотношением $L = \sqrt{D}\tau$ (где D — коэффициент диффузии, слабо зависящий от облучения и уровня легирования полупроводника [8]), соотношение (1) можно записать в виде

$$L^{-2}(\Phi) - L^{-2}(0) = \frac{K}{D} \Phi. \quad (2)$$

Как видно из рис. 2, экспериментально полученные данные о влиянии облучения на L_p удовлетворительно описываются соотношением (2). Это подтверждает предположение о доминирующей роли радиационных дефектов в увеличении скорости рекомбинации избыточных ННЗ.

Таким образом, показано, что диффузионная длина ННЗ в ZnSe, как и в других ранее изученных полупроводниках [8], весьма чувствительна к введению радиационных дефектов и существенно уменьшается при сравнительно небольших дозах облучения, при которых концентрация основных носителей заряда изменяется незначительно.

Основной причиной уменьшения L_p является повышение скорости рекомбинации из-за образования радиационных дефектов акцепторного типа.

Список литературы

- [1] Mach R., Ludwig W. // Phys. St. Sol. 1974. V. A23. N 2. P. 507—516.
- [2] Mora S., Romeo N., Tarricone L. // Sol. St. Commun. 1980. V. 33. N 11. P. 1147—1149.
- [3] Williams J. O., Crawford E. S., Miller B., Patterson A. M., Scott M. D. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1983. V. 16. N 12. P. 2297—2306.
- [4] Оконечников А. П., Мельник Н. Н. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 5. С. 894—896.
- [5] Оконечников А. П., Мельник Н. Н. // ПТЭ. 1986. № 5. С. 71—74.
- [6] Hall R. N. // Phys. Rev. 1952. V. 87. N 2. P. 387—393. Shockley W., Read W. T. // Phys. Rev. 1952. V. 87. N 5. P. 835—842.
- [7] Loferksi J. J., Rappaport P. // J. Appl. Phys. 1959. V. 30. N 8. P. 1181—1183.
- [8] Коршунов Ф. П., Богатырев Ю. В., Вавилов В. А. Воздействие радиации на интегральные микросхемы. Минск, 1986. 254 с.

Уральский политехнический институт
им. С. М. Кирова
Свердловск

Получено 12.07.1989
Принято к печати 19.09.1989

ФТП, том 24, вып. 4, 1990

НЕЛИНЕЙНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАХ ДЛЯ БАРЬЕРОВ С СЕДЛОВЫМИ ТОЧКАМИ

Шикина Н. И., Шикин В. Б.

Одной из проблем в интерпретации ВАХ для барьеров различного происхождения в полупроводниках (границы зерен, границы бикристаллов, дислокационные барьеры и т. д.) является неоднозначное поведение ВАХ в промежуточной области разности потенциалов V на берегах барьера. В одних случаях [1] ВАХ имеет плато при переходе от омического режима к нелинейному росту тока j с увеличением V (рис. 1, а, участок б—б' на кривой). В других экспериментах [2] такое плато отсутствует, и ВАХ имеет вид рис. 1, б.

Качественное объяснение наличия плато вида рис. 1, а содержится в большом числе работ, использующих одномерную модель барьера с глубокими электронными состояниями, локализованными на его вершине (см., например, [3—5]). Рост тока через барьер в данном случае сопровождается возрастанием плотности свободных электронов на вершине барьера, что в свою очередь ведет к повышению коэффициента заполнения локализованных электронных состояний на вершине барьера и, как следствие, к увеличению высоты барьера.

Причины отсутствия плато, т. е. условия реализации ВАХ вида рис. 1, б, до сих пор систематически не обсуждались.¹ В данном сообщении показано, что ВАХ без перегибов может иметь место для барьера с седловыми точками. Конкретные аргументы в пользу монотонной нелинейности $j(V)$, т. е. ВАХ с $\partial j / \partial V > 0$, получены для барьера, возникающего в связи с перекрытием

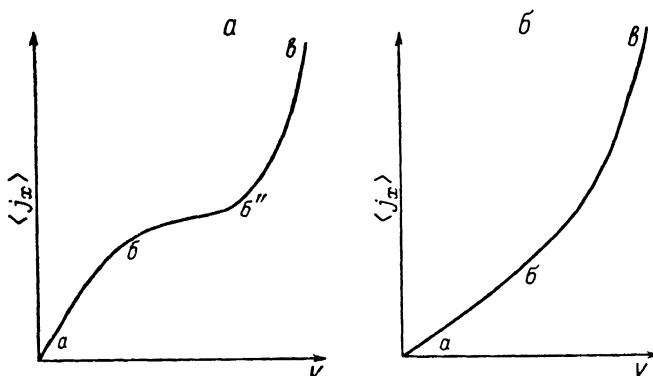


Рис. 1.

соседних ридовских цилиндров системы параллельных заряженных дислокаций, расположенных эквидистантно с периодом d , например, вдоль границы бикристалла (рис. 2), выбранной за ось Oy .

А. Предположим, что перекрытие h соседних ридовских цилиндров мало́ так что хорда b на рис. 2 гораздо меньше радиуса ридовского цилиндра R , $b \ll R$. Предполагается также, что радиус R много больше дебаевского радиуса

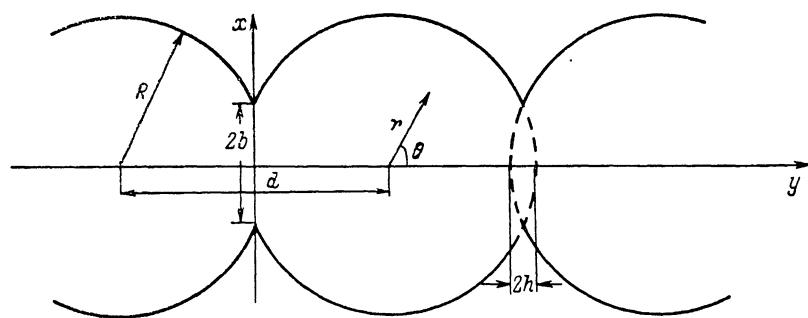


Рис. 2.

r_d данного полупроводника n -типа, $r_d^2 = \epsilon T / (4\pi e^2 n_d)$, где ϵ — диэлектрическая постоянная полупроводника, n_d — плотность доноров, T — температура, которая достаточно высока, для того чтобы считать все донорные состояния ионизованными, но слишком мала по сравнению с высотой барьера $e\varphi_s$ в седловой точке. В окрестности экстремума φ_s потенциал $\varphi(x, y)$ имеет вид

$$e\varphi(x, y) = e\varphi_s + \frac{k}{2} y^2 - \frac{q}{2} x^2 + \dots, \quad (1)$$

$$\varphi_s = \frac{4\pi e n_d}{\epsilon} h^2, \quad k = 8\pi e^2 n_d \epsilon^{-1}, \quad q = \frac{8\pi e^2 n_d h}{\epsilon R}, \quad R \gg b \gg h \gg r_d, \quad T \ll e\varphi_s,$$

$$b \simeq (2Rh)^{1/2}.$$

Здесь k и q — кривизны потенциала в седловой точке.

¹ В работах Райха с соавт. (см., например, [6]) обсуждается влияние случайных седловых точек на эффективную высоту барьера. Структура ВАХ здесь не исследовалась.

В условиях (1) общая задача о вычислении тока через барьер распадается на две части. Сперва нужно решить задачу о распределении потенциала $\psi(r, \theta)$ на барьере в отсутствие тока через барьер. Затем решается уравнение $\operatorname{div} j = 0$ с заданным распределением потенциала $\psi(r, \theta)$, пропорционального разности потенциалов V .

Учитывая неравенство $R \gg r_d$, задачу о структуре $\psi(r, \theta)$ можно формулировать как граничную

$$\Delta\psi = 0, \quad \psi(r, \theta)|_{r=R} = \begin{cases} +V, & 0 \leq \theta \leq \pi - \alpha, \\ -V, & \pi + \alpha \leq \theta \leq 2\pi - \alpha, \end{cases} \quad (2)$$

где $\alpha = b/R \ll 1$.

В результате

$$\psi(r, \theta) = \frac{2V}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{2Rr \sin \theta}{R^2 - r^2}. \quad (3)$$

Плотность дополнительных поверхностных зарядов вдоль границ ридовских цилиндров есть

$$\sigma(\theta) = \frac{\epsilon}{4\pi} \frac{\partial \psi}{\partial r} \Big|_{r=R} = -\frac{\epsilon V}{2\pi^2 R \sin \theta}, \quad |\theta| \geq \alpha. \quad (4)$$

Появление зарядов $\sigma(\theta)$ (4) под действием разности потенциалов V реально означает, что границы барьера смещаются относительно своего равновесного положения в отсутствие V на величину $\xi(\theta)$:

$$\xi(\theta) = \frac{\sigma(\theta)}{en_d}, \quad \xi_{\max} \ll b. \quad (5)$$

В результате барьер теряет симметрию относительно плоскости, в которой находятся заряженные дислокации. Это обстоятельство и является основной причиной того, что в одномерной модели появление разности потенциалов V на берегах барьера сразу же меняет условия заполнения локализованных состояний на вершине барьера. В случае $\xi(\theta)$ (5) смещения ридовских границ резко неоднородны. Они максимальны в зонах контактов и малы в меру $b/R \ll 1$ вдали от них. Следовательно, можно полагать, что в нулевом по параметру $b/R \ll 1$ приближении начало координат задачи (2) совпадает с положением заряженной дислокации, и причины для изменения плотности свободных электронов на ось ридовских цилиндров под влиянием разности потенциалов V отсутствуют [ибо потенциал $\psi(r, \theta)$ из (3) равен нулю при $r \rightarrow 0$].

Б. Расчет тока через барьер $e\varphi(xy)$ (1) выполняется в диффузионном приближении, т. е. полагается, что

$$\operatorname{div} j = 0, \quad j = -\mu [T \nabla n + en \nabla (\varphi + \psi)] \quad (6)$$

с граничными условиями, отвечающими наличию разности потенциалов V на берегах барьера. Здесь μ — подвижность электронов. Формально задача (6) совпадает с аналогичной задачей о распаде метастабильного состояния в теории фазовых переходов 1-го рода, подробно исследованной Лангером [7]. Опуская в связи с этим детали расчета, приведем конечные результаты для зависимости среднего тока $\langle j_x \rangle$ через данную седловую точку в зависимости от разности V

$$\langle j_x \rangle = \langle j_x^0 \rangle \left(1 + \frac{1}{2} \frac{eV}{T} + \dots \right), \quad (7)$$

$$\langle j_x^0 \rangle = \frac{e\mu n_d V}{d} \left(\frac{q}{k} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{e\varphi_s}{T} \right), \quad (7a)$$

$$d = R - h, \quad h \ll R, \quad \xi_{\max} \ll b.$$

Очевидно, ВАХ (7) имеет вид рис. 1, б.

Список литературы

- [1] Еременко В. Г., Фарбер Б. Я., Якимов Е. Б. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 7. С. 1313—1315.
- [2] McGonial G. C., Thomson D. J., Shaw J. G., Gard H. C. // Phys. Rev. B. 1983. V. 28. N 10. P. 5908—5922.
- [3] Teylor W. E., Odell N. H., Fan H. F. // Phys. Rev. 1953. V. 88. N 4. P. 867—875.
- [4] Гольдман Е. И., Ждан А. Т. // ФТП. 1976. Т. 10. В. 10. С. 1839—1844.
- [5] Гольдман Е. И., Гуляев И. Б., Ждан А. Г., Сандромирский В. Б. // ФТП. 1976. Т. 10. В. 11. С. 2089—2093.
- [6] Гусятников А. Н., Раих М. Э. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 6. С. 1077—1084.
- [7] Langer J. S. // Ann. Phys. 1968. V. 54. P. 258—275.

Институт физики твердого тела АН СССР
Черноголовка

Получено 30.08.1989
Принято к печати 19.09.1989

ФТП, том 24, вып. 4, 1990

ПРОСТОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ВАХ МОП ТРАНЗИСТОРОВ

Усеинов Р. Г., Зебрев Г. И.

Известно, что поверхностные состояния (ПС) на границе раздела диэлектрик—полупроводник в МДП структурах оказывают существенное влияние на параметры соответствующих приборов. В частности, ПС влияют на пороговое напряжение V_{th} и эффективную канальную подвижность МОП транзисторов (МОПТ) μ_{eff} . ПС могут генерироваться под влиянием ионизирующего излучения (ИИ) при инжекции горячих носителей из канала в подзатворный окисел, при термополевых нагрузках и т. д.

Существуют различные методы определения плотности ПС на границе раздела $Si-SiO_2$ [1, 2]. Однако традиционно используемые методы, основанные на измерении $C-V_g$ - или $G-V_g$ -зависимости (C — емкость МДП структуры, G — ее высокочастотная проводимость, V_g — напряжение на затворе), мало пригодны для транзисторов. Это связано как с техническими трудностями (с необходимостью измерять слишком малые емкости), так и с трудностью интерпретации получаемых результатов [2]. Существуют методы, позволяющие оценивать плотность ПС непосредственно для транзисторов: метод зарядовой накачки [3], а также так называемая подпороговая техника [4, 5]. Первый из них позволяет получить интегральное значение заряда на ПС в интервале ~ 0.8 эВ в запрещенной зоне Si, второй метод дает величину D_{it} — среднюю дифференциальную плотность ПС для значения поверхностного потенциала $\Phi_s \simeq 1.5 \Phi_B$ (Φ_B — энергетическая разность между уровнем Ферми и серединой запрещенной зоны в объеме полупроводника). Хотя метод зарядовой накачки дает в ряде случаев хорошие результаты при измерении ПС в МОПТ, он достаточно сложен технически. Кроме того, при оценке интервала в запрещенной зоне Si, который вносит вклад в измеряемую интегральную плотность ПС, необходимо знание сечения захвата носителей на ПС, которое является экспоненциальной функцией поверхностного потенциала Φ_s , а также функцией от дифференциальной плотности ПС D_{it} [2]. Поэтому интерпретация результатов метода зарядовой накачки не является простой. Что же касается подпороговой методики, то, хотя этот метод более прост технически, он может в определенных ситуациях завышать D_{it} . В [6] было показано, что в тех случаях, когда имеются неоднородности пространственного распределения захваченного в окисле заряда, наблюдаемый логарифмический наклон S подпороговых ВАХ определяется не только D_{it} , но и этими неоднородностями. В [7] приводятся доказательства того, что этот метод дает неверные результаты для приборов, облученных ИИ при азотной